

ウエハ上アルミニウム電極用無電解ニッケル/金めっきプロセス

Electroless Ni/Au Plating Process for Al Electrode on Wafer

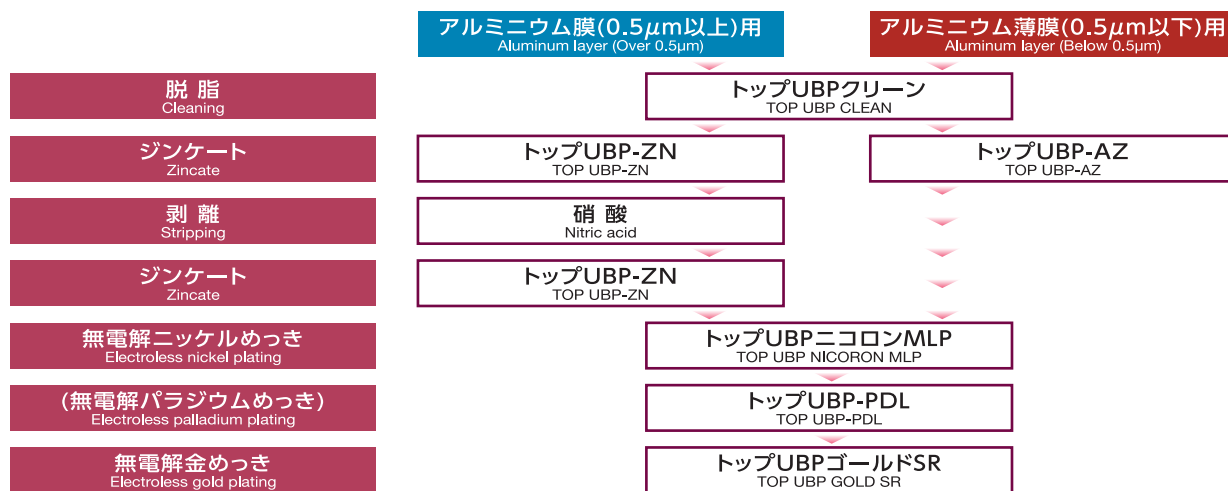
トップUBPプロセス

TOP UBP PROCESS

- 純アルミ、アルミニウム合金スパッタ薄膜へめっきが可能
Plating process for aluminum- and aluminum-alloy sputtering ultra thin layer
- 電極とめっき皮膜間の密着性に優れる
High adhesion performance between electrodes and plating films
- ニッケル皮膜は熱処理後においても耐クラック性に優れる
Nickel films have high-crack resistance even after heat treatment

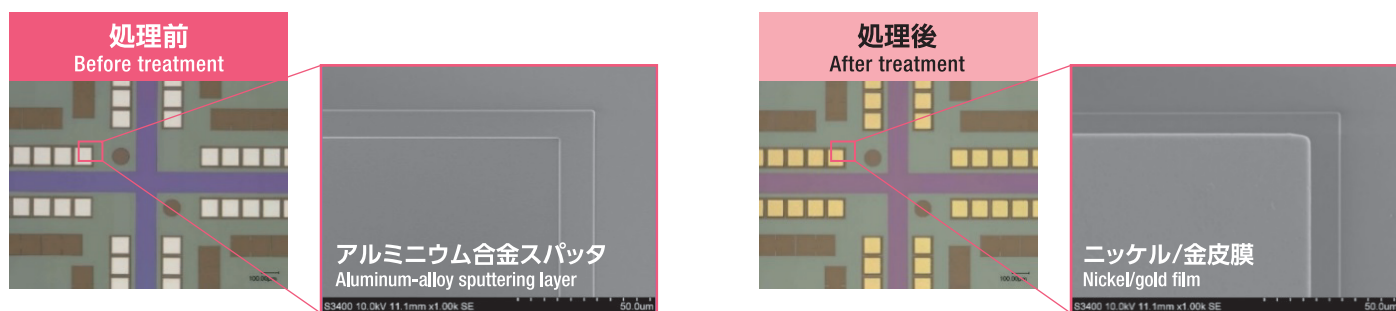
処理工程

Process



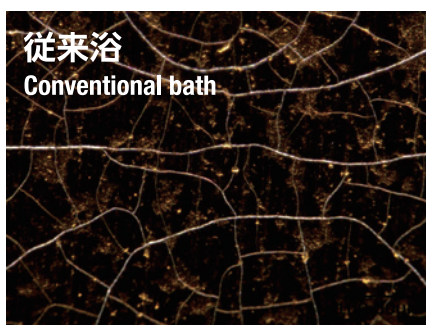
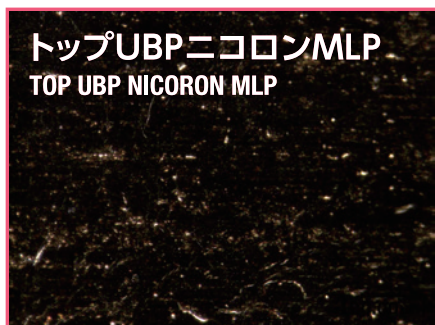
アルミニウム合金スパッタ膜への良好なめっきつきまわり性

Great deposition performance on aluminum-alloy sputtering layer



耐クラック性に優れた無電解ニッケル皮膜を形成

Electroless nickel films with high crack resistance can be formed



エリクセン試験機による押し込み試験
Indentation test by Erichsen tester

- ニッケル膜厚: 3μm
Nickel thickness
- 押し込み幅: 0.5mm
Indentation width
- 350°C 30分熱処理後
After heat treatment 350°C 30min